

Cechy:

- odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip solderballing)
- dobra przyczepność do elementów przez ponad 24 godziny od jej nałożenia
- pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin ciągłego druku co zapewnia jej przedłużony czas przydatności (stencil life)
- minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostałości po lutowaniu (no clean), które dzięki swojej elastyczności ułatwiają przenikanie igieł testerów
- pasta posiada dużą wierność odtwarzania szczegółów (fine pitch)
- możliwości druku z prędkością rakli do 150 mm/s

Zastosowanie:

- Pasta przeznaczona do lutowania elementów w montażu powierzchniowym SMD.



Właściwości fizykochemiczne:

Właściwości	Wartości	Normy
rodzaj spoiwa	Sn96,5Ag3Cu0,5	
klasyfikacja topnika	REL - 0	J-STD - 004
test chromatografii bibułowej na Cl	spełnia (REL - 0)	IPC TM 650
gęstość	≈ 4,6 g/cm ³	IPC-TM 650T
uziarnienie	25-45 μm	IPC-TM 650T
kleistość	1,0 G/mm ² po 24h	IPC J-STD - 005
SIR-IPC	> 2,6*10 ⁹ Ω, pomiar po 7 dniach	IPC J-STD 004 (85°C, w 85%)
przydatność do druku	ponad 8h	

Symbole:

SIR - Surface Insulation Resistance -oporność powierzchniowa rezystancji

IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - amerykańskie normy definiujące wymagania techniczne past i topników

